研究報告書（第４報～第３４報）の発行

報告書No.	タ　イ　ト　ル	発 行	価 格 （会員※）	価 格 （非会員）
第４報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 振動に関する研究	H 3. 3.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第５報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 コネクタのはんだクラックの研究	H 3.11.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第６報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 効率的な熱衝撃試験法に関する研究	H 4. 3.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第７報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 表面実装印刷配線板に関する研究	H 4. 3.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第８報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 洗浄に関する研究	H 5. 6.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第９報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 無洗浄化による脱フロンの研究	H 7. 1.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 10 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 温度変化と湿度による加速試験に関する研究	H 7. 3.	3,300 (内税 300)	4,950 (内税 450)
第 11 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 表面実装配線板はんだ部のき裂に関する研究	H 8. 8.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 12 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 無洗浄化による脱フロンの研究	H 8.10.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 13 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 無洗浄化による脱フロンの研究	H 9. 9.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 14 報	実験報告書(ランダム振動試験に関する研究) H4.4～H7.3.	H 7. 4.	2,200 (内税 200)	2,200 (内税 200)
第 16 報	静電気破壊に関する研究報告書 　－人体静電気放電によるIC破壊－	H11. 3.	2,200 (内税 200)	3,300 (内税 300)
第 17 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 部品実装に関する研究	H11.10.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 18 報	鉛フリーはんだの手はんだ付け信頼性	H13.10.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 19 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 はんだバンプ接合部(CSP)の落下衝撃信頼性に関する研究	H13.10.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 20 報	電子機器の電磁ノイズ対策に関する研究 放射イミュニティの定量的評価に関する研究	H13.10.	2,200 (内税 200)	3,300 (内税 300)
第 21 報	電子機器の電磁ノイズ対策に関する研究 電子機器巨体開口部の GHz帯電磁シールド性能に関する実験的検討	H16.3	2,200 (内税 200)	3,300 (内税 300)
第 22 報	電子機器の熱設計に関する研究～簡易温度予測式の検討～	H16.11.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 23 報	鉛フリーはんだの接合信頼性に関する研究 はんだぬれ性および耐衝撃性関する実験的検証	H16.11.	2,200 (内税 200)	3,300 (内税 300)
第 24 報	実装印刷配線板信頼性に関する研究 鉛フリーフローはんだのはんだ付け性の信頼性	H17. 5.	2,200 (内税 200)	3,300 (内税 300)
第 25 報	鉛フリーはんだの接合信頼性に関する研究 実装外観品質基準の適切性に関する評価	H20. 3.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)

第 26 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～シミュレーションモデルの簡略化に関する検討～	H20.10.	2,200 (内税 200)	3,300 (内税 300)
第 27 報	鉛フリー実装後の信頼性に関する研究 ～ウィスカに関する研究～	H22.10.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 28 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～シミュレーションモデルの簡略化に関する検討Ⅱ～	H23.11.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 29 報	鉛フリー実装後の信頼性に関する研究 低銀鉛フリーはんだの接合信頼性に関する研究	H27. 3.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 30 報	画像応用システム開発に関する研究 手話認識を題材とした画像処理技術の蓄積	H27.10.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 31 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～トロイダルコイルの熱解析モデル～	H29. 2.	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 32 報	GHz帯差動伝送に関する研究 ～高速伝送路の信号品質改善と電磁ノイズ低減に関する研究	R1.11	5,500 (内税 500)	6,600 (内税 600)
第 33 報	電子機器の熱設計に関する研究 ～放熱シートの熱解析モデル～	R4.1	3,300 (内税 300)	4,400 (内税 400)
第 34 報	AIを用いた実装基板の検査技術に関する研究	R5.9	3,850 (内税 350)	4,950 (内税 450)

※会員：中部エレクトロニクス振興会入会企業　（価格は消費税・送料込み）

【お申し込み/お支払い方法】

・下記申込書にご記入の上、E-mail または FAX にてお送り下さい。

・申込書が届き次第、報告書と請求書をお送りいたしますので、後日お振込みください。

【お申込み/お問い合わせ先】

中部エレクトロニクス振興会　事務局

〒460-0008　名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋市商工会議所ビル 5 階

Tel：(052)228-1760　Fax：(052)228-0997　E-mail：cea@eleshin.org

……　キ　リ　ト　リ　……

月　　日

研究報告書　購入申込書			
報告書No.		冊　数	
会　社　名 （機関名）			
住　　所	〒		
所属部課		氏　名	
電　　話		E-mail	